

3 证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（    ）
参与单位名称	<u>2025年3月25日</u> Morgan Stanley、Hao Capital、BlackRock、Azimut Investment、Grand Alliance Asset Management 等  <u>2025年3月26日</u> Mirae Capital、HSZ Group、润晖投资、摩根基金、财通基金、洲和资本、光大证券资产管理等
时间	2025年3月25日、2025年3月26日
调研方式	线上及线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）
投资者关系活动主要内容介绍	

<p>公司介绍</p>	<p>芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。</p> <p>公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processor IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。</p> <p>基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。</p> <p>为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。</p> <p>基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。</p> <p>芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。</p>
-------------	---

2020年至2022年，公司营业收入复合增长率约为33%。2021年，在行业产能紧张的情况下，公司实现量产业务收入同比增长约35%，营业收入同比增长约42%，实现净利润扭亏为盈。2022年，全球半导体产业下行，公司营业收入逆势增长约25%，净利润与扣非后净利润均实现盈利，成功实现了“摘U”。2023年，在产业环境非常艰难的情况下，公司仍然保持了上半年净利润、扣非后净利润均为正。受全球经济增速放缓，半导体行业周期下行以及去库存的影响，公司仅三个季度收入同比下滑。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司2024年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024年第三季度营业收入创历年三季度收入新高，同比增长23.60%，根据公司《2024年年度业绩快报公告》，公司预计第四季度收入同比增长超17%，全年营业收入预计基本与2023年持平。2024年下半年，公司芯片设计业务收入同比增长约81%，知识产权授权使用费业务收入同比增长约21%，量产业务收入同比下降约4%。2024年第四季度，公司芯片设计业务收入同比增长约81%，知识产权授权使用费业务收入同比下降约28%，量产业务收入同比增长约32%，体现了公司收入受行业下行周期影响较晚、恢复增长较早的特点。

截至2024年末，公司订单情况良好，在手订单24.06亿元，较三季度末的21.38亿元进一步提升近13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024年四季度公司新签订单超9.4亿元，2024年下半年新签订单总额较2024年上半年提升超38%，较2023年下半年同比提升超36%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的2023年上半年大幅提升超66%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。

经过20多年的持续高研发投入，公司已经拥有丰富且优质的技术储备，并在别的公司不招人、少招人的产业下行周期，芯原逆向思维，在2024届校招中近1万人进行了全球统一在线笔试，约1,800人进入面试环节，我们录取了200多名应届毕业生，其中，硕士985、211的占比为

	<p>97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%。</p> <p>公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用。公司在三年前就开始研发超轻量、超低功耗的 AI/AR 眼镜芯片设计平台，为全球知名的互联网企业定制了 AR 眼镜专用芯片，还与其始终在线的开源项目展开深度合作，形成了完整的技术平台。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p><b>问题：请问公司对未来境内外收入占比如何展望？</b></p> <p>回复：公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展，长期来看，公司境外收入占比约占整体收入的三成左右。在 2024 年上半年，公司实现境内销售收入 6.03 亿元，占营业收入比重为 64.72%；境外销售收入 3.29 亿元，占营业收入比重为 35.28%。</p> <p><b>问题：请问公司芯片设计业务收入中先进制程的收入占比大情况，主要来自于哪些下游应用领域？</b></p> <p>回复：在一站式芯片定制服务方面，芯原拥有从先进 5nmFinFET、22nmFD-SOI 到传统 250nmCMOS 制程的设计能力，掌握的工艺涵盖全球主要晶圆厂的主流工艺、特殊工艺等，已拥有 14nm/10nm/7nm/5nmFinFET 和 28nm/22nmFD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已有多个 4nm/5nm 一站式服务项目正在进行。在 2024 年前三季度，公司实现芯片设计业务收入 5.18 亿元，其中 14nm 及以下工艺节点收入占比 86.22%，主要分布于数据处理、自动驾驶、消费电子等领域。</p> <p><b>问题：请问公司在 AI 领域有哪些布局，客户合作情况如何？</b></p>

回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如数据中心/服务器等高性能云侧计算设备，以及智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备。其中，公司在智慧汽车、AR/VR 等增量市场积极布局已经为多家国际行业巨头客户提供了技术和服 务，目前，芯原全球领先的 NPU IP 已在 82 家客户的 142 款 AI 芯片获得采用，覆盖服务器、汽车、智能手机、可穿戴设备等 10 个市场领域，集成芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，在嵌入式 AI/NPU 领域全球领先；此外，芯原用于高性能 AI 计算的 GPU 和 GPGPU-AI IP 还在全球范围内获得多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。

**问题：请问公司在 RISC-V 领域有哪些布局？**

回复：RISC-V 是一个免费、开放的指令集架构。随着物联网时代的发展，场景需求碎片化、差异化，对定制化、可修改、低功耗、低成本 RISC-V CPU 带来极大需求；目前，全球已有大量的集成电路设计公司 RISC-V 用在自己的芯片中，并将 RISC-V 技术从嵌入式场景成功拓展到了工业控制、自动驾驶、人工智能、通信、数据中心等对算力要求更高的场景中。

RISC-V 产业的发展，除了发展技术本身，还需要发展生态，作为领先的芯片设计服务和半导体 IP 供应商，芯原在 RISC-V 领域进行了积极布局。2018 年 9 月，由上海集成电路行业协会推荐芯原股份作为首任理事长单位牵头建立的中国 RISC-V 产业联盟(CRVIC)，截至 2024 年 12 月，共有 198 家会员单位。由中国 RISC-V 产业联盟和芯原共同举办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了四届。每届会议上，约十家本土企业集中发布十余款国产 RISC-V 芯片新品，广泛应用于消费电子、智能家居、可穿戴设备、通信、汽车、工业控制等多个领域。

目前，芯原已通过将第三方 RISC-V IP 与芯原业已获得市场验证的

	<p>自有 IP 优化协同，集成到公司的平台或系统解决方案中，来推动 RISC-V 应用生态的发展；此外公司也在 RISC-V 领域进行了股权投资等布局。</p>
--	---